



平成23年2月期 第1四半期決算短信

平成22年7月6日

上場取引所 福

上場会社名 ジェイエムテクノロジー株式会社
 コード番号 2423 URL <http://www.jmtech.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長
 問合せ先責任者 (役職名) 管理部長
 四半期報告書提出予定日 平成22年7月15日
 配当支払開始予定日 —

(氏名) 植木 一夫
 (氏名) 柴田 義治

TEL 092-272-4151

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年2月期第1四半期の連結業績(平成22年3月1日～平成22年5月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年2月期第1四半期	800	1.9	△8	—	△9	—	△5	—
22年2月期第1四半期	785	—	1	—	1	—	△6	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年2月期第1四半期	△368.36	—
22年2月期第1四半期	△473.66	—

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
23年2月期第1四半期	1,119	828	74.0	56,529.45
22年2月期	1,207	841	69.7	57,397.81

(参考) 自己資本 23年2月期第1四半期 828百万円 22年2月期 841百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年2月期	—	—	—	500.00	500.00
23年2月期	—	—	—	—	—
23年2月期(予想)	—	—	—	1,000.00	1,000.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成23年2月期の連結業績予想(平成22年3月1日～平成23年2月28日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期	1,510	△1.5	13	△29.8	25	29.5	12	904.8	880.89
連結累計期間	3,200	△1.5	54	101.9	65	117.0	33	—	2,307.14

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
新規 ― 社 (社名) 除外 ― 社 (社名)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有
詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】「4. その他」を参照して下さい。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無

詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】「4. その他」を参照して下さい。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	23年2月期第1四半期	17,718株	22年2月期	17,718株
② 期末自己株式数	23年2月期第1四半期	3,055株	22年2月期	3,055株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間)	23年2月期第1四半期	14,663株	22年2月期第1四半期	14,663株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は添付資料の5ページ【定性的情報・財務諸表等】「3. 連結業績予想に関する定性的情報」を参照して下さい。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長に支えられた輸出拡大や、政府の景気対策の奏功等により、一部の業種において景気回復の兆しが見られるものの、厳しい雇用情勢や個人消費の低迷が続くなど、依然として先行き不透明な状況にあります。

情報システム業界におきましては、顧客の情報化投資の縮小、延期等、設備投資を抑制する動きが続いており、受注環境は依然として厳しい状況にあります。

半導体業界におきましては、パソコンやデジタル家電の需要回復を背景に、半導体メーカーの生産に回復の兆しが見られるものの、設備投資が本格的に回復するまでには至っていません。

このような状況のもと、当社グループは積極的な受注活動を行うこととともに各種経費の見直し・削減に努め、厳しい状況を乗り越えるべく対応を行いました。

以上の結果、売上高は800,320千円（前年同期比1.9%増）となったものの、未稼働・低稼働人員の発生等により収益性が悪化したことや、海外事業や子会社吸収合併の準備等に伴う販売費及び一般管理費の一時的な増加、子会社の業績不振等により、営業損失は8,348千円（前年同期は営業利益1,567千円）、経常損失は9,171千円（前年同期は経常利益1,318千円）となりました。また、子会社における税効果会計の見直しの影響から、四半期純損失は5,401千円（前年同期は四半期純損失6,945千円）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（1）IT事業

IT事業につきましては、ITインフラの構築・設計支援、業務系を中心としたWeb系システムの開発等の分野を中心に、既存の顧客との取引拡大に注力いたしました。

しかしながら、景気の先行き不透明感による顧客の情報化投資の縮小や、大型案件の終了等の影響により、売上高は528,523千円（前年同期比20.6%減）、営業利益は24,912千円（前年同期比43.6%減）となりました。

（2）半導体事業

半導体事業につきましては、引き続きアプライドマテリアルズジャパン株式会社からの受注の確保を図るとともに、国内半導体メーカーからの直受け業務の拡大や部品販売等の強化に注力いたしました結果、売上高は271,796千円（前年同期比127.1%増）、営業利益は34,420千円（前年同期比138.9%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は1,119,992千円、負債は291,101千円、純資産は828,891千円となりました。

（流動資産）

当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、979,252千円であり、その主な内訳は、現金及び預金574,340千円、受取手形及び売掛金311,563千円、仕掛品37,033千円、繰延税金資産29,205千円であります。

（固定資産）

当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、140,740千円であり、その主な内訳は、パソコンをはじめとした工具器具備品13,850千円、連結子会社の吸収合併に伴い発生したのれん44,926千円、株式会社ソフトラインの子会社化に伴い発生したのれん13,692千円、事業所等の差入保証金39,448千円であります。

（流動負債）

当第1四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、291,101千円であり、その主な内訳は、未払金145,345千円、未払費用45,412千円、未払法人税等14,594千円、未払消費税等18,217千円、賞与引当金39,287千円であります。

（純資産）

当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は、配当金の支払7,331千円、四半期純損失5,401千円の計上により、828,891千円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から496千円減少し、574,340千円となりました。当第1四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期連結会計期間の営業活動の結果、得られた資金は14,024千円となりました。これは税金等調整前四半期純損失9,688千円に対し、減価償却費2,741千円、のれん償却額2,203千円、売上債権の減少額99,388千円、たな卸資産の減少額13,865千円、役員退職慰労引当金の減少10,000千円、未払金の減少額66,315千円、未払費用の減少額44,232千円、未払消費税等の増加14,147千円、賞与引当金の増加33,499千円、法人税等の支払額17,001千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期連結会計期間の投資活動の結果、使用した資金は8,126千円となりました。これは有形固定資産の取得による支出1,673千円、無形固定資産の取得による支出3,357千円、投資有価証券の取得による支出5,000千円、差入保証金の回収による収入2,563千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期連結会計期間の財務活動の結果、使用した資金は6,394千円となりました。これは、配当金の支払額6,394千円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年2月期の見通しにつきましては、平成22年4月15日に発表いたしました第2四半期累計期間及び通期業績予想の数値から変更はございません。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(簡便な会計処理)

①一般債権の貸倒見積高

当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

②繰延税金資産の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

(会計基準等の改正に伴う変更)

受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更

受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第1四半期連結会計期間より適用し、当第1四半期連結会計期間に着手した受注制作のソフトウェアにかかる契約から、当第1四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のソフトウェア制作については検収基準を適用しております。

なお、当第1四半期連結会計期間においては、工事進行基準を適用すべきソフトウェア制作がないため、この変更による損益に与える影響はありません。

5. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年5月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	574,340	574,837
受取手形及び売掛金	311,563	408,125
商品及び製品	1,195	644
仕掛品	37,033	50,998
原材料及び貯蔵品	233	684
その他	56,468	40,676
貸倒引当金	△1,584	△4,625
流動資産合計	979,252	1,071,342
固定資産		
有形固定資産	25,486	24,406
無形固定資産		
のれん	58,619	60,822
その他	8,552	5,677
無形固定資産合計	67,171	66,500
投資その他の資産		
その他	51,142	45,759
貸倒引当金	△3,060	△500
投資その他の資産合計	48,082	45,259
固定資産合計	140,740	136,166
資産合計	1,119,992	1,207,508
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,283	13,075
未払金	145,345	209,589
未払費用	45,412	89,645
賞与引当金	39,287	5,788
未払法人税等	14,594	21,073
その他	37,177	25,856
流動負債	291,101	365,027
固定負債		
その他	—	856
固定負債合計	—	856
負債合計	291,101	365,883

(単位：千円)

	当第1四半期連結会計期間末 (平成22年5月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	326,200	326,200
資本剰余金	348,080	348,080
利益剰余金	227,683	240,416
自己株式	△73,072	△73,072
株主資本合計	828,891	841,624
純資産合計	828,891	841,624
負債純資産合計	1,119,992	1,207,508

(2) 四半期連結損益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成21年3月1日 至 平成21年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成22年3月1日 至 平成22年5月31日)
売上高	785,701	800,320
売上原価	663,816	677,752
売上総利益	121,885	122,568
販売費及び一般管理費	120,317	130,917
営業利益又は営業損失(△)	1,567	△8,348
営業外収益		
受取利息	168	95
受取配当金	17	—
雑収入	23	26
営業外収益	209	121
営業外費用		
リース解約損	—	176
支払手数料	—	320
賃貸借契約解約損	426	366
雑損失	32	80
営業外費用	458	944
経常利益又は経常損失(△)	1,318	△9,171
特別利益		
貸倒引当金戻入額	265	480
特別利益	265	480
特別損失		
固定資産除却損	—	998
特別損失合計	—	998
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,583	△9,688
法人税、住民税及び事業税	15,077	13,181
法人税等調整額	△6,548	△17,469
法人税等合計	8,529	△4,287
四半期純損失(△)	△6,945	△5,401

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成21年3月1日 至 平成21年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成22年3月1日 至 平成22年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	1,583	△9,688
減価償却費	3,080	2,741
のれん償却額	2,203	2,203
賞与引当金の増減額(△は減少)	24,325	33,499
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	—	△10,000
有形固定資産除却損	—	407
売上債権の増減額(△は増加)	52,195	99,388
たな卸資産の増減額(△は増加)	19,119	13,865
仕入債務の増減額(△は減少)	1,770	△3,778
未払金の増減額(△は減少)	26,948	△66,315
未払費用の増減額(△は減少)	△33,981	△44,232
未払消費税等の増減額(△は減少)	△3,379	14,147
その他	7,288	△1,306
小計	101,154	30,930
利息及び配当金の受取額	190	95
法人税等の支払額	△18,912	△17,001
営業活動によるキャッシュ・フロー	82,432	14,024
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△4,337	△1,673
無形固定資産の取得による支出	—	△3,357
投資有価証券の取得による支出	—	△5,000
投資有価証券の売却による収入	1,838	—
差入保証金の差入による支出	△436	△823
差入保証金の回収による収入	778	2,563
貸付けによる支出	△760	—
貸付金の回収による収入	297	164
その他	49	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,570	△8,126
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△12,589	△6,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,589	△6,394
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	67,273	△496
現金及び現金同等物の期首残高	511,408	574,837
現金及び現金同等物の四半期末残高	578,681	574,340

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第1四半期連結累計期間（自 平成21年3月1日 至 平成21年5月31日）

	I T事業 (千円)	半導体事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全 社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	666,027	119,674	785,701	—	785,701
(2) セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	—	—	—	—
計	666,027	119,674	785,701	—	785,701
営業利益	44,133	14,406	58,540	(56,972)	1,567

(注) 1. 事業は取扱いサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各事業区分に属する主要な製品及びサービスは次のとおりであります。

事業区分	主要製品・サービス
I T事業	I Tソフト設計・開発・販売、I Tインフラ設計・構築
半導体事業	半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス、半導体製造装置関連部品販売

当第1四半期連結累計期間（自 平成22年3月1日 至 平成22年5月31日）

	I T事業 (千円)	半導体事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全 社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	528,523	271,796	800,320	—	800,320
(2) セグメント間の内部売上 高又は振替高	—	—	—	—	—
計	528,523	271,796	800,320	—	800,320
営業利益	24,912	34,420	59,333	(67,682)	△8,348

(注) 1. 事業は取扱いサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

2. 各事業区分に属する主要な製品及びサービスは次のとおりであります。

事業区分	主要製品・サービス
I T事業	I Tソフト設計・開発・販売、I Tインフラ設計・構築
半導体事業	半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス、半導体製造装置関連部品販売

〔所在地別セグメント情報〕

前第1四半期連結累計期間（自平成21年3月1日 至平成21年5月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間（自平成22年3月1日 至平成22年5月31日）

当第1四半期連結累計期間において、JM Singapore IT Solutions Pte. Ltd. を新規設立し、連結の範囲に含めておりますが、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメントの情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

前第1四半期連結累計期間（自平成21年3月1日 至平成21年5月31日）
海外売上高がないため該当事項はありません。

当第1四半期連結累計期間（自平成22年3月1日 至平成22年5月31日）
海外売上高がないため該当事項はありません。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

6. その他の情報

（重要な後発事象）

当社は、平成22年4月15日開催の取締役会決議に基づき、平成22年6月1日を合併期日として当社の100%子会社である株式会社ソフトラインを吸収合併いたしました。

（1）合併の目的

情報システム事業における人材、情報等を当社に一元化し、経営資源の効率的な活用と意思決定の迅速化を図ることにより急速に変化する経営環境に対応していくことを目的として当社の100%子会社である株式会社ソフトラインを吸収合併するものであります。

（2）合併期日

平成22年6月1日

（3）合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ソフトラインは解散いたしました。

（4）合併比率、合併交付金等

消滅会社である株式会社ソフトラインは当社の100%子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払いはありません。

（5）合併後の吸収合併存続会社の概要

商号	ジェイエムテクノロジー株式会社
住所	福岡市博多区下川端町3番1号
代表者の氏名	代表取締役会長兼社長 植木 一夫
資本金	326,200千円
事業の内容	半導体製造装置の技術サービス、ソフトウェア設計開発

（6）実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年11月15日公表分 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。